



Fully Automatic Multifunction Wafer Mounter

DFM2800

进一步实现超薄晶圆的高速处理

实现高良率的薄型化技术

DFM2800是与背面研磨机组成联机系统的特殊晶圆贴膜机，用于加工 $\phi 300$ mm超薄晶圆。从在经过DGP8761薄化处理后的晶圆上粘贴切割胶膜，再加上框架，到剥除表面保护胶膜为止，整合制程一贯化，安全可靠地执行。本设备还适用于新一代SiP (System in Package) 制造时所需要的切割胶膜一体化的DAF (Die Attach Film) 粘贴。

适用于25 μm 以下厚度的超薄晶圆加工

为了满足 $\phi 300$ mm、25 μm 以下厚度的薄型化要求，本设备将内部晶圆搬运次数降低为旧机型的1/5，并尽可能减少超薄晶圆发生破损的风险。另外还在各搬运垫/台上配置了清洗装置，防止微粒混入致使晶圆破损。



DFM2800

DGP8761

高生产效率

合理配置各搬运机构，连续工作时最大生产效率增加约50 %^{*}，有助于提高生产性。（与DFM2700相比较）

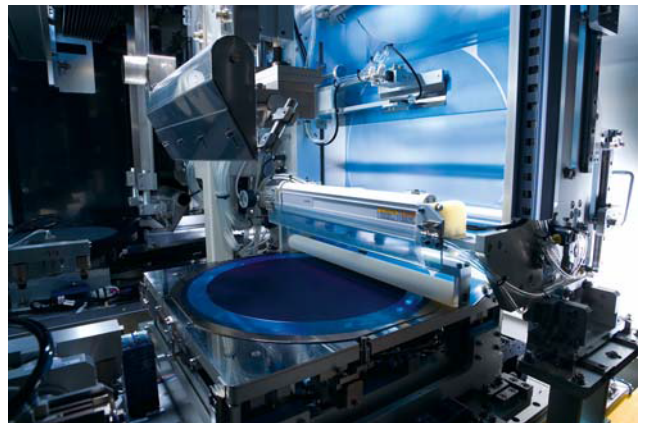
^{*}实际生产效率取决于晶圆贴膜技术时间及表面保护胶膜的剥离时间。

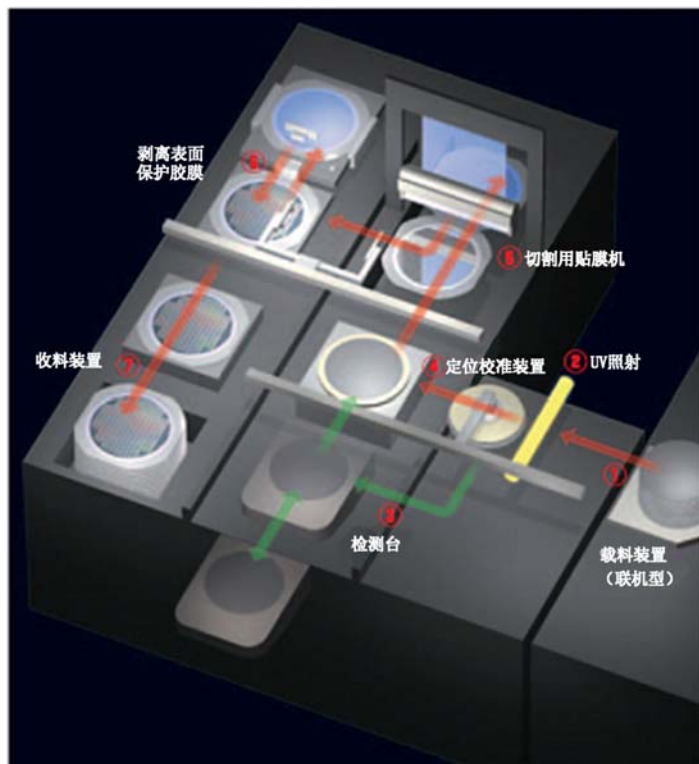
丰富的特殊选配，可满足多种需求

- 机械手臂/独立晶圆加载机，使本设备可作为独立设备运行
- 在设备内部对切割胶膜进行预切割的预切割装置
- 表面保护胶膜的粘着式胶膜剥离装置
- 晶圆贴膜后用于进行条形码管理的晶圆表面ID识别装置（条形码辨识系统）

操作简便

本设备继承了DFM2700的操作方式，并进一步扩大了画面尺寸，提高了画面质量，使用更容易，操作更简单。另外，在与DGP8761组成的联机系统中，可以由DGP8761选择DFM2800的加工程序，进行开始/结束等综合管理，进一步提高了使用便利性。





工作流程系统

- ①接受从背面研磨机传送过来的工作物→
- ②对表面保护膜进行UV（紫外线）照射（在使用UV胶膜时）→
- ③将工作物搬运到检测台上（任意选项）→
- ④藉由影像处理实施定位校准作业→
- ⑤使用切割胶膜或者 2 in 1 DAF胶膜，将工作物安装到胶膜框架上→
- ⑥剥离表面保护膜→
- ⑦放入胶膜框架储存盒

Specifications		
Specification	Unit	
Wafer Diameter	mm	φ 200/ φ 300
Wafer attachment precision and X/Y direction (frame mount)	mm	±0.5 or less
Wafer attachment precision and θ direction (frame mount)	deg	±0.5 or less
Dicing tape attachment precision and X/Y direction	mm	±1.0 or less
Machine dimensions(W×D×H)	mm	2,150×2,643×1,800
Machine weight	kg	Approx.3,100

■使用条件

- 请使用大气压露点在-15℃以下，残余油分为0.1 ppm，过滤度在0.01 μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
 - 请将放置机械设备的房间室温设定在20℃-25℃之间，并将波动范围控制在±1℃以内。
 - 其它，请避免设备受到撞击及外界的有感振动。另外，请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油雾的装置附近。
- ※ 为了改进设备，本公司可能在预先不通知用户的情况下，就对本规格实施变更，因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。